

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-012

| | |
|----------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
| 参与单位名称 | 中信建投证券、国信证券、长盛基金、民生加银基金、银华基金、中邮资管、中金资管、光大永明、南方基金 |
| 时间 | 2025 年 12 月 18 日 |
| 地点 | 公司和线上 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 合规总监：李珮媛 证券事务代表：徐雯 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题一：公司目前的订单和产能情况如何？未来产值预期如何？</p> <p>答：受益于行业需求的持续增长和公司市场份额的稳步提升，公司在手订单充足，产能利用率保持中高位运行。未来产值依赖于客户的实际需求以及所承接的具体产品类型，公司将保持灵活的产能策略，以客户需求为导向动态调整资源投入。</p> <p>问题二：公司 PSPI 光刻胶已量产，目前除现有客户外，是否有其他头部晶圆厂进入合作洽谈阶段？</p> <p>答：目前，公司正性 PSPI 光刻胶已在部分客户实现小批量交付，并</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>同步推进多家头部晶圆厂的验证工作。此外公司超高感度 PSPI 和低温固化负性 PSPI 等产品也处于客户端验证阶段，以适配不同技术需求。</p> <p>问题三：公司目前涉及的产品品类众多，研发团队如何分配的，是否有侧重点和相应的优先级？</p> <p>答：公司研发团队分为产品研发、工艺研发、应用技术研发三大类，研发资源主要向高端化、差异化方向倾斜，尤其聚焦于国产化率低、“卡脖子”的关键材料，旨在实现进口替代并参与前沿竞争。其中，超高纯电镀基液及添加剂、光刻胶及配套树脂、光刻胶配套试剂是重点投入领域，并设有专业团队覆盖全产品线。</p> <p>问题四：从下游需求来看目前市场情况如何？</p> <p>答：目前终端需求呈现高端化、智能化发展趋势，5G、AI、汽车电子等新兴领域成为主要增长动力，国产替代进程亦在多个细分领域加速推进。就公司业务而言，人工智能算力需求爆发，直接推动先进封装市场快速扩容，有利于带动公司服务于高密度互联的产品扩量；存储芯片（如 HBM、HBF）领域需求旺盛，晶圆领域的市场空间进一步广阔；此外，PCB（HDI）、SLP、IC 载板、OLED 显示领域国内技术突破明显，正逐步切入高端市场，为公司在泛半导体领域配套电子化学品的扩量提供明确增长路径。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025 年 12 月 18 日 |